

Anhang - B -

Übersicht der Leiterplattenabmessungen für die SMD- und Konventionelle- Bestückung und Prüfung

Reine SMD Baugruppe:

- Maximale Abmessungen für die Maschinen.
 - Pastendruckprozess: **450 mm x 410 mm**
 - Rakelfläche: **395 mm x 380 mm**
 - Bestückung: **540 mm x 510 mm**
 - Reflowlöten: **625 mm x 520 mm**
 - Leiterplattenstärke: **4,80 mm**

Daraus ergibt sich für einen automatischen SMD Fertigungsprozess:

- **maximale Leiterplattengröße von: 450 mm x 410 mm,**
- **maximale Bestückungsfläche von: 395 mm x 380 mm**
- **minimale Leiterplattengröße für alle Fertigungsschritte von: 50 mm x 50 mm**

- Achtung -

Leiterplatten ohne Randfreiheit von 5,0 mm können nicht verarbeitet werden.

Gemischtbestückte BG mit SMD und THT

Beim automatischen Fertigungsprozess beträgt die maximale Leiterplattengröße: **380 mm x 290 mm.**

Reine THT Baugruppe:

Beim automatischen Fertigungsprozess beträgt die maximale Leiterplattengröße: **450 mm x 290 mm.**

Einpresstechnik:

Maximale Leiterplattengröße: **500 mm x 300 mm**
Maximale Bestückungsfläche: **500 mm x 200 mm**

Polar – Tester:

Maximale Leiterplattengröße: **500 mm x 300 mm**
Maximale Abtastfläche: **450 mm x 300 mm**
Maximale Gesamthöhe der bestückten Leiterplatte: **100 mm**

Wird es erforderlich ein anderes Format zu verwenden, ist Rücksprache mit DESY, Fachgruppe -ZE- zu halten

Stand: 01.01.2018